

EMC对策用铁氧体 IC，连接器用

SP系列（板形）

Issue date: May 2011

●记载内容，在没有予告的情况下有可能改进和变更，请予以谅解。

● RoHS 指令的对应：表示除了依据 EU Directive 2002/95/EC 免除的用途之外，未使用铅，镉，汞，六价铬及特定溴系难燃剂 PBB，PBDE 等。

EMC对策用铁氧体磁心

IC, 连接器用

SP系列 (板形)

特点

- 只需贴在IC, 扁平电缆等的上面即可发挥极佳的噪音吸收效果。
- 还可根据客户需求制作各种形状。

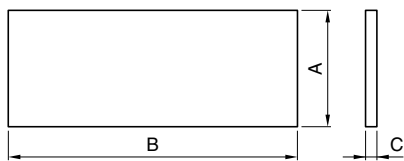
用途

影像设备, 音响设备, 电装设备, 通信设备, 办公自动化(OA)设备及其他。

材质特性

材质	初始磁导率 μ_i	温度系数 $\alpha_{\mu ir}$ $\times 10^{-6}/^{\circ}\text{C}$	居里 温度 T_c ($^{\circ}\text{C}$)	饱和磁通密度 $B_s(\text{mT})$
HF70	1500	1 to 6	>100	280[H=1600A/m]
HF57	600	3 to 15	>150	370[H=4000A/m]
HF40	120	8 to 18	>250	410[H=4000A/m]
HF30	45	5 to 15	>300	320[H=4000A/m]

形状・尺寸



产品名称的识别法

HF70	SP	1	$\times$	6	$\times$	17
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		

- (1) 材质名
- (2) 形状系列
- (3) 高度 (C)
- (4) 外尺寸 (A)
- (5) 外尺寸 (B)

• 关于材质, 形状的组合, 请咨询本公司。